公司代码:688041　　公司简称:海光信息

海光信息技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的风险因素。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海光信息	688041	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	徐文超	杨尽歌
电话	010-82177855	010-82177855
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座5层
电子信箱	investor@hygon.cn	investor@hygon.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,034,343,872.26	35,638,165,817.46	1.11
归属于上市公司股东的净资产	25,373,280,514.38	22,493,222,807.40	12.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,099,020,774.81	5,464,235,057.15	66.52
利润总额	2,162,612,869.80	1,638,826,242.20	31.96
归属于上市公司股东的净利润	1,798,467,918.03	1,201,451,841.15	49.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,631,411,695.35	1,090,013,467.67	49.67
经营活动产生的现金流量净额	-427,541,001.36	2,176,641,209.26	-119.64
加权平均净资产收益率(%)	7.56	5.75	增加1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.52	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.52	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	29.15	31.31	减少2.16个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)			133,170			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			不适用			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
曙光信息产业股份有限公司	境内非国有法人	27.96	649,900,000	0	0	无 0
天津海富天鼎科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.81	251,194,546	0	0	无 0
成都产业投资集团有限公司	国有法人	7.21	167,600,000	0	0	无 0
成都高新投资集团有限公司	国有法人	5.92	137,600,000	0	0	无 0
成都蓝海轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.59	129,866,364	0	0	无 0
成都高新集萃科技有限公司	国有法人	3.87	90,000,000	0	0	无 0
李金阳	境内自然人	2.83	65,732,946	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.46	57,208,993	0	0	无 0
国新投资有限公司	国有法人	0.65	15,023,816	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64	14,797,819	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新投资集团有限公司及成都高新集萃科技有限公司系一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:688432　　公司简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	有研硅	688432	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨波	孙媛
电话	010-82087088	010-82087088
办公地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2.2主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	565,126.04	565,309.13	549,445.93	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	456,352.89	451,713	452,081.87	1.03
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	66,480.69	54,850.08	49,091.49	21.20
利润总额	17,908.01	14,960.83	15,026.54	19.70
归属于上市公司股东的净利润	13,282.52	10,566.19	10,603.47	25.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,883.46	7,342.5	7,356.54	20.99
经营活动产生的现金流量净额	20,762.93	16,191.81	14,664.41	28.23
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.41	2.42	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1065	0.0849	0.0852	25.44
稀释每股收益(元/股)	0.1065	0.0849	0.0852	25.37
研发投入占营业收入的比例(%)	6.54	8.06	9.01	减少1.52个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)			49,169			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			/			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			/			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	30.77	384,750,000	0	0	无 0
株式会社RS Technologies	境外法人	25.16	314,590,400	0	0	无 0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	18.43	230,422,500	0	0	无 0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	1.15	14,319,986	0	0	无 0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	0.68	8,559,953	0	0	无 0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	7,387,185	0	0	无 0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57	7,086,890	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.54	6,700,466	0	0	无 0
杭州长添私募基金管理有限公司-长添金泉一号私募证券投资基金	其他	0.52	6,529,900	0	0	无 0
全国社保基金一一五组合	其他	0.34	4,236,127	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为万永文。 2.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

(一)募集资金的使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为本公司及股东获取更多回报,公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含超募资金)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-039)。

截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	5,000.00	2026.06.11-2026.09.12	否
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	8,400.00	2026.05.26-2026.08.26	否
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	2,600.00	2026.05.26-2026.08.26	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	12,000.00	2026.04.13-2026.07.14	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司分别于2026年3月19日、2026年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案》。同意使用超募资金19,470.15万元、自有资金20,529.85万元设立全资子公司“国晶半导体材料(包头)有限公司”并以此为主体投资新建“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”。具体内容详见公司2026年3月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2026-009)。

报告期内,公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日,公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金,并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司

董事会

2026年8月14日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额(注1)			1,663,967,265.37	本年度投入募集资金总额			93,406,790.27				
变更用途的募集资金总额			119,220,000.00	已累计投入募集资金总额			1,292,325,703.22				
变更用途的募集资金总额比例			7.16%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充研发与营运资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	-	247,814,701.35	-10,013,398.65	96.12	不适用	不适用	不适用	否
集成电路用8英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00	19,469,433.90	357,796,677.05	-27,027,622.95	92.98	2025年12月(注5)	不适用	不适用	否
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	有	357,347,600.00	238,127,600.00	238,127,600.00	4,734,011.69	192,889,010.75	-45,238,589.25	81.00	2026年12月	不适用	不适用	否
集成电路用8英寸硅片扩产项目	无	-	119,220,000.00	119,220,000.00	42,583,426.18	43,353,707.98	-75,866,292.02	36.36	2026年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	66,786,871.77	841,854,097.13	-158,145,902.87	84.19	—	—	—	—
超募资金永久补流(注2)	无	不适用	385,000,000.00	385,000,000.00	-	385,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购(注2)	无	不适用	35,935,687.59	35,935,687.59	-	35,935,687.59	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化(注2)	无	-	48,330,000.00	48,330,000.00	4,374,000.00	7,290,000.00	-41,040,000.00	15.08	2026年12月	不适用	不适用	否
大尺寸半导体硅单晶基地建设项目(注2)	无	-	194,701,500.00	194,701,500.00	22,245,918.50	22,245,918.50	-172,455,581.50	11.43	2027年12月	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000,000.00	1,663,967,187.59	1,663,967,187.59	93,406,790.27	1,292,325,703.22	-371,641,484.37	77.67	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				详见附注4								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内,公司未发生此情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内,公司未发生此情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内,公司未发生此情况								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				报告期内,公司未发生此情况								

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币1,663,967,265.37元。

注2:截至2026年6月30日,超募资金总额663,967,265.37元,其中已投入385,000,000.00元用于永久补流;35,935,687.59元(含印花税、交易佣金等交易费用)用于股份回购;7,290,000.00元用于8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目;22,245,918.50元用于“大尺寸半导体硅单晶基地建设项目”。

注3:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

注4:“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”未达到计划进度原因系受厂房设计及招投标等客观因素影响,开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响,加之贸易摩擦导致刻蚀材料出口下滑,以及部分客户转向自产进一步挤压市场份额,公司经过审慎研究,决定对该项目进行调整。具体内容详见本公司于2025年10月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》(公告编号:2025-035)。

注5:“集成电路用8英寸硅片扩产项目”已于2025年12月结项,截至期末投入进度为92.98%,系部分尾款尚未结清等。

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

发行名称				2022年首次公开发行股份募集资金								
募集资金到账日期				2022年11月7日								
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
集成电路刻蚀设备用硅材料项目	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	生产建设	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号	238,127,600.00	238,127,600.00	4,734,011.69	192,889,010.75	81.00	2026年12月	不适用	不适用	否
集成电路用8英寸硅片再扩产项目	集成电路用8英寸硅片扩产项目	生产建设	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号	119,220,000.00	119,220,000.00	42,583,426.18	43,353,707.98	36.36	2026年12月	不适用	不适用	否
合计					357,347,600.00	357,347,600.00	47,317,437.87	236,242,718.73	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				2025年10月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》,基于当前市场环境的深入分析,结合公司发展战略,同意将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金11,922万元用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”,新建项目预计完成时间为2026年12月;原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》(公告编号:2025-035)。								
未达到计划进度或预计效益的情况和原因(分具体募投项目)				“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”受厂房设计及招投标等客观因素影响,开工较预期延迟。后期考虑到近年来大直径单晶市场需求疲软、价格下行及产业链库存压力影响,加之贸易战导致刻蚀材料出口下滑,公司经过审慎研究,决定对该项目进行调整。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

公司代码:688260　　公司简称:昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“四、风险因素”中详细阐述可能面临的各种风险,提请投资者注意查阅。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	昀冢科技	688260	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈艳	孔志渊
电话	0512-36831116	0512-36831116
办公地址	江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号	江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号
电子信箱	IR@gyzet.com	IR@gyzet.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,837,628,289.88	1,566,208,154.53	18.08
归属于上市公司股东的净资产	139,520,065.76	124,431,279.34	12.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	379,282,806.17	246,157,614.49	53.68
利润总额	-116,885,832.86	-124,529,303.93	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-91,284,850.49	-99,936,540.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,646,428.49	-104,182,022.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	23,578,681.13	-24,236,385.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-104.20	-57.29	减少46.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.7606	-0.8328	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.7546	-0.8299	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.70	20.04	减少8.34个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)			11,471			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
苏州昀冢电子科技股份有限公司-苏州昀冢合信企业(有限合伙)	其他	8.29	10,064,830	0	0	无 0
王宾	境内自然人	8.35	10,023,220	0	0	无 0
苏州昀冢电子科技股份有限公司-苏州昀冢合信企业(有限合伙)	其他	8.26	9,911,830	0	0	无 0
苏州昀冢电子科技股份有限公司-苏州昀冢合信企业(有限合伙)	其他	7.96	9,556,490	0	0	无 0
苏州昀冢电子科技股份有限公司-苏州昀冢合信企业(有限合伙)	其他	6.55	7,865,650	0	0	无 0
李倩	境内自然人	1.91	2,290,123	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金	其他	1.79	2,145,261	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-财通匠心精选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.67	2,006,023	0	0	无 0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	1.51	1,806,844	0	0	无 0
徐州市策略企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.42	1,701,090	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王宾为苏州昀冢一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀冢二企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀冢三企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀冢四企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人,系一致行动关系。上述为徐州市策略企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人,系一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688260　证券简称:昀冢科技　公告编号:2026-048

苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2026年8月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的各项规定;公司2026年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2026年半年度的经营成果和财务状况等事项;公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议,董事会认为:公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)》等的有关规定,不会对公司的经营情况产生重大影响,亦不会影响核心管理团队的稳定性。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。董事莫凌全、胡艳为2024年限制性股票激励计划激励对象,回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,董事会认为:公司对本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。董事莫凌全、胡艳为2026年限制性股票激励计划激励对象,回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(四)审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议,董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2025年年度股东会的授权,公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026年8月12日为授予日,以授予价格18.55元/股,向97名激励对象授予199.00万股限制性股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。董事莫凌全、胡艳为2026年限制性股票激励计划激励对象,回避本议案的表决。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

(五)审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议,董事会认为:为践行以“投资者为本”的发展理念,公司推动落实“提质增效重回报”行动方案,有利于提高公司质量、完善企业治理、增强投资者回报、加强投资者沟通、强化“关键少数”履职责任,将促进公司高质量发展。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(六)审议通过《关于调整组织架构的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码:688260　证券简称:昀冢科技　公告编号:2026-050

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昀冢科技”)于2026年8月12日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)的规定和公司2025年年度股东会的授权,公司董事会对本次激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年3月30日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

同日,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026年4月2日至2026年6月23日,公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司董事会提名、薪酬与考核委员会未收到任何人对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年6月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票